



2025年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年10月14日

上場会社名 株式会社TMH

上場取引所 東 福

コード番号 280A URL <https://www.tmh-inc.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 榎並 大輔

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理部長

(氏名) 関 真希

TEL 097 (576) 7666

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無：有

決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年11月期第3四半期の連結業績（2024年12月1日～2025年8月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年11月期第3四半期	6,929	—	209	—	198	—	135	—
2024年11月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 2025年11月期第3四半期 135百万円 (—%) 2024年11月期第3四半期 一百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年11月期第3四半期	36.95	36.02
2024年11月期第3四半期	—	—

(注) 1. 当社は、2025年11月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2024年11月期第3四半期の数値および2025年11月期第3四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。

2. 当社は、2024年12月4日に東京証券取引所グロース市場および福岡証券取引所Q-Boardに上場したため、2025年11月期第3四半期における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、新規上場日から2025年11月期第3四半期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年11月期第3四半期	3,030	1,315	43.4
2024年11月期	—	—	—

(参考) 自己資本 2025年11月期第3四半期 1,315百万円 2024年11月期 一百万円

(注) 当社は、2025年11月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2024年11月期の数値を記載しておりません。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年11月期	—	—	—	0.00	0.00
2025年11月期	—	0.00	—		
2025年11月期（予想）				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2025年11月期の連結業績予想（2024年12月1日～2025年11月30日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	7,871 ～8,366	—	296 ～366	—	286 ～356	—	192 ～240	—	52.42 ～65.57

- （注） 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有
2. 当社は、2025年11月期第3四半期より連結決算に移行しております。そのため対前期増減率を記載しておりません。詳細は、本日（2025年10月14日）に公表いたしました「連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照ください。
3. 当社グループが販売する半導体製造装置の販売金額は1案件あたりの金額が大きいものもあり、2025年11月期に売上を計上すると予想していた案件が翌期での売上となった場合、業績に与える影響が現時点では大きいため、レンジ形式により開示しております。
4. 「1株当たり当期純利益」について、公募により2024年12月に発行した株式数（190,000株）およびオーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資により2025年1月に発行した株式数（73,100株）等を期中平均株式数に含めております。

※ 注記事項

- （1）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：有
- 新規 1社 （社名）TMH KOREA Inc.、除外 1社 （社名）—
- （注）詳細は添付資料P. 6「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（連結の範囲の変更）」をご覧ください。

- （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

- （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

- （4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2025年11月期3Q	3,698,100株	2024年11月期	3,366,250株
② 期末自己株式数	2025年11月期3Q	—株	2024年11月期	—株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年11月期3Q	3,673,954株	2024年11月期3Q	3,366,250株

- （注） 1. 当社は、2024年7月31日付で普通株式1株につき250株の割合で株式分割を行っております。2024年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期中平均株式数（四半期累計）」を算定しております。
2. 2024年11月期において当社が発行していた種類株式について、その株式の内容より「普通株式と同等の株式」として取り扱っていたことから、2024年11月期第3四半期の「期中平均株式数（四半期累計）」に含めております。なお、種類株式のすべてについて、取得請求権の行使により、2024年7月1日付で自己株式として取得し、その対価として種類株式1株につき、普通株式1株を交付し、取得した種類株式を同日付ですべて消却いたしました。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 経営成績等の概況（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(連結の範囲の変更)	6
(セグメント情報等の注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	6

1. 経営成績等の概況

当社グループは、当第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間および前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間（2024年12月1日～2025年8月31日）におけるわが国経済は、底堅く推移いたしました。一方、世界に目を向けると、米国においてトランプ大統領が全面的な関税措置を発動したことによる貿易摩擦の激化や、それに伴う世界経済の減速、中国大手不動産デベロッパーである恒大グループの香港証券取引所における上場廃止に象徴される中国経済の成長鈍化リスク、さらにロシア・ウクライナ戦争に加えてイラン・イスラエル戦争の勃発など、国際情勢は引き続き不安定な状況にあり、世界経済は依然として不透明感が残存しております。半導体業界では、生成AIの急速な普及を背景としたデータセンター投資や、PC・スマートフォンへのAI搭載拡大が進展しております。加えて、日常生活を支える電子機器や自動車などの社会インフラ分野における半導体需要も継続的に市場が形成されており、レガシーからミドルノードに至る幅広い領域で安定的な需要が見込まれております。一方、中国では半導体業界における投資抑制の動きも見られ、今後の動向を注視する必要があります。

国内では、2024年12月にTSMC熊本工場が量産を開始したほか、第2工場の造成工事にも着工し、2027年末以降の稼働開始を予定しております。Rapidusにおいても、次世代半導体の量産に向けた装置の導入が2024年12月より本格化しており、政府によるサプライチェーン強靱化支援を追い風に、国内半導体産業の成長が一層期待される状況です。

このような状況の中、当社グループの当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高6,929,478千円、営業利益209,171千円、経常利益198,067千円、親会社株主に帰属する四半期純利益135,735千円となりました。なお、当第3四半期連結会計期間において、一部大型装置案件の搬出順序のバラつき等が影響し、当第3四半期連結会計期間の売上高は407,465千円、営業損失は76,378千円、経常損失は75,979千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は52,897千円となりました。この損失は一過性のものであると認識しており、当社グループの売上および利益は期を通じて概ね堅調に推移する見込みです。

また、当社は2025年7月にTMH KOREA Inc. を連結子会社として設立いたしました。なお同社の決算日は9月30日であり、四半期連結財務諸表の作成に当たっては同決算日現在の財務諸表を使用いたしますが、当第3四半期連結累計期間において同社は四半期財務諸表を作成しておりませんので、当第3四半期連結会計期間末までの期間に発生した重要な取引について、連結上必要な調整を行っております。

なお、当社グループは半導体製造フィールドソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(2) 当四半期の財政状態の概況

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は3,030,792千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金864,907千円、商品1,107,412千円、未収消費税等624,458千円、固定資産272,037千円です。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は1,715,108千円となりました。その主な内訳は、買掛金722,146千円、契約負債628,691千円、長期借入金149,258千円です。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は1,315,683千円となりました。その内訳は、資本金299,090千円、資本剰余金293,010千円、利益剰余金723,581千円です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2025年10月14日公表の「連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間 (2025年8月31日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	864,907
売掛金	133,556
商品	1,107,412
未収消費税等	624,458
その他	28,419
流動資産合計	2,758,754
固定資産	
有形固定資産	214,524
無形固定資産	20,829
投資その他の資産	36,683
固定資産合計	272,037
資産合計	3,030,792
負債の部	
流動負債	
買掛金	722,146
契約負債	628,691
賞与引当金	24,570
その他	188,117
流動負債合計	1,563,525
固定負債	
長期借入金	149,258
その他	2,325
固定負債合計	151,583
負債合計	1,715,108
純資産の部	
株主資本	
資本金	299,090
資本剰余金	293,010
利益剰余金	723,581
株主資本合計	1,315,683
純資産合計	1,315,683
負債純資産合計	3,030,792

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年12月1日 至 2025年8月31日)
売上高	6,929,478
売上原価	6,274,943
売上総利益	654,534
販売費及び一般管理費	445,363
営業利益	209,171
営業外収益	
受取利息	8,228
その他	1,264
営業外収益合計	9,493
営業外費用	
支払利息	1,699
売上債権売却損	3,549
株式交付費	2,289
上場関連費用	8,460
為替差損	4,597
営業外費用合計	20,596
経常利益	198,067
税金等調整前四半期純利益	198,067
法人税、住民税及び事業税	49,914
法人税等調整額	12,418
法人税等合計	62,332
四半期純利益	135,735
非支配株主に帰属する四半期純利益	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	135,735

（四半期連結包括利益計算書）

（第3四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	当第3四半期連結累計期間 （自 2024年12月1日 至 2025年8月31日）
四半期純利益	135,735
四半期包括利益	135,735
（内訳）	
親会社株主に係る四半期包括利益	135,735
非支配株主に係る四半期包括利益	—

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（連結の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

当第3四半期連結会計期間において、TMH KOREA Inc.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

（2）連結子会社の事業年度等に関する事項

TMH KOREA Inc.の決算日は、9月30日であります。

四半期連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、同社は当第3四半期連結会計期間において設立したため四半期財務諸表を作成しておりませんので、当第3四半期連結累計期間に発生した重要な取引について、連結上必要な調整を行っております。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間（自 2024年12月1日 至 2025年8月31日）

当社グループは、半導体製造フィールドソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2024年12月4日付で東京証券取引所グロース市場および福岡証券取引所Q-B o a r dに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年12月3日を払込期日とする一般募集による新株式（普通株式 190,000株）の発行を行いました。またそれに合わせて株式会社S B I証券が行ったオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式（普通株式 73,100株）の発行を行い、2025年1月8日に払込が完了いたしました。

また、当第3四半期連結累計期間において、新株予約権（ストック・オプション）の行使による新株式（普通株式 68,750株）の発行を行っております。

この結果、当第3四半期連結累計期間において資本金が199,090千円、資本準備金が199,090千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が299,090千円、資本剰余金が293,010千円となっております。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

当第3四半期連結累計期間
（自 2024年12月1日
至 2025年8月31日）

減価償却費

7,738千円